

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2024-015

江西沃格光电股份有限公司

关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的公告》（公告编号：2024-012），针对上述公告中关于本次项目建设可能存在的风险，进行补充说明，具体如下：

1. 项目整体建设周期较长，对公司当年业绩不构成重大影响

湖北通格微年产 100 万平米芯片板级封装载板项目总投资金额预计为人民币 121,564.23 万元，截至目前，该项目已投入资金为 11,784.55 万元，该项目后续所需投资金额拟为 109,779.68 万元。

项目产能将进行分批建设投入，项目总产能建设周期在 6 个月以上，截至目前总产能主体厂房已完成建设封顶，产能搭建将分期实施投入。预计一期投入人民币 5 亿元左右，含主体厂房建设、净房装修、土建、一期设备采购等，一期产能达产时间预计今年下半年，后续投入将根据项目建设和市场推广情况，具有不确定性。由于项目规模量产需要一定时间，对于公司当年营业收入和净利润没有重大影响。

2. 本项目投资金额较大，资金来源为公司自有资金和通格微银团项目贷款，详见公司于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013），后续资金筹措在一定程度上拉高公司资产负债率。

3. 本次投资可能存在投资损失风险，项目实施可能会受到行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理经验不足等因素影响，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日